

GK.6220.10.2015

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem z dnia 09.11.2015 r. (13.11.2015 r. – data wpływu do tut. Urzędu) Zakładu „Diehl Controls Polska” Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 6, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zakładu „Diehl Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez powiększenie linii produkcyjnej wraz z budową nowych obiektów budowlanych, w załączeniu przekazuję akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

Planowana inwestycja realizowana będzie w 3 etapach:

- Etap I (A) polegał będzie na budowie hali magazynowej składającej się z jednej kondygnacji oraz łącznika, budynku technicznego i wiaty;
- Etap II (B) polegał będzie na budowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno – biurowym składającym się z dwóch kondygnacji;
- Etap III (C) polegał będzie na budowie hali produkcyjnej składającej się z jednej kondygnacji.

Ponadto planuje się budowę stacji trafo, budynku sprężarkowni, wiaty na palety oraz wiaty, pod którą będą magazynowane odpady.

Czas realizacji przedsięwzięcia (Etapy I i II) planuje się na 12 miesięcy, natomiast Etap III na 8 miesięcy, przy czym jego realizacja będzie przesunięta w czasie.

Budowa nowych budynków wiązać się będzie z wycinką niektórych drzew oraz krzewów na terenie Zakładu.

Do przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie utwardzeń zewnętrznych w postaci dróg dojazdowych, pożarowych, placów manewrowych oraz parkingu.

Łączna powierzchnia zabudowy projektowanej wynosić będzie 8000,00 m², natomiast powierzchnia terenu utwardzonego projektowanego 7375,64 m².

W budynkach znajdują się pomieszczenia produkcyjne oraz część administracyjno – biurowa. Inwestor stosuje w produkcji rozwinięte technologie. W zakładzie obecnie znajdują się następujące elementy:

- linie montażu powierzchniowego SMD płytek elektronicznych;
- maszyny do montażu elementów axialnych, radialnych;
- linie lutownicze i stanowiska montażu elementów elektronicznych;
- maszyny do lutowania selektywnego;
- maszyny do nadruku paneli do sprzętu AGD;
- pomieszczenie do montażu wyświetlaczy TFT;
- urządzenia testowe;
- pomieszczenia laboratorium jakości i testów niezawodności;
- narzędziownia-warsztat;
- pomieszczenia socjalne i administracyjno-biurowe.

Na 13 liniach montażu powierzchniowego SMD wyposażonych w sitodrukarki pasty lutowniczej DEK, maszyny SIPLACE układające komponenty SMD oraz piece lutownicze REHM odbywa się proces lutowania.

Obwody drukowane układane są w tzw. magazynkach, a następnie przemieszczane linią taśmową do sitodrukarki, gdzie następuje nanoszenie pasty lutowniczej. Pasta nakładana jest przez szablon lutowniczy, przecierany środkiem czyszczącym. Po przejściu tak przygotowanych płytek do automatu SMD następuje nakładanie poszczególnych komponentów. Tak przygotowana płytka przechodzi do pieca Rehm, gdzie następuje lutowanie rozpliwowe w piecu konwekcyjnym w osłonie azotu. Cały cykl przebiega automatycznie. Montaż komponentów SMD przebiega również poprzez nakładanie kropek kleju dozownikiem kleju, nakładanie komponentów SMD w maszynach Siplace, utwardzanie kleju w piecu Rehm.

Po montażu powierzchniowym płytka elektroniczna uzbrajana jest w elementy axialne i radialne na 4 maszynach VCD oraz 3 maszynach RADIAL.

Po montażu automatycznym płytka w zależności od typu wędruje na jedną z 8 linii montażu ręcznego. Każda z linii wyposażona jest od 5 do 9 stanowisk pracy. Po uzbrojeniu ręcznym płytka lutowana jest w ramie lutowniczej na fali (w piecu lutowniczym).

Na tym etapie pracownicy ręcznie montują komponenty elektroniczne na płytkę drukowaną, która w ramie lutowniczej trafia transportem do pieca, gdzie następuje pokrycie topnikiem wyprowadzeń komponentów montowanych w płytce drukowanej, a następnie lutowanie wmontowanych do płytki komponentów w piecu lutowniczym. Po przejściu lutowania następuje kontrola wyrobu. Dodatkowe czynności przy tej operacji to mycie ram lutowniczych w specjalnych myjkach.

Po montażu ręcznym płytki elektroniczne są rozdzielane za pomocą 4 frezarek i przechodzą na stanowiska testowania komponentów elektronicznych i pakowania.

Alternatywnie lub dodatkowo bardzo specyficzne komponenty są lutowane na 5 maszynach do lutowania selektywnego.

Produkcja paneli składa się z etapu nadruku estetycznego na panelach za pomocą 5 tampodrukarek. Panele łączone są wraz z wcześniej wyprodukowaną elektroniką w kompletny panel sterujący w 4 gniazdach produkcyjnych. W procesie wykorzystywane są również 3 niezależne stanowiska przygotowania paneli (usuwania ładunków powierzchniowych) typu plasma i corona treatment.

Czyste obudowy (panele) dostarczone z magazynu są nadrukowywane zgodnie z wymaganiami klienta na maszynie do tampodruku. Nadruk następuje w efekcie przeniesienia farby przez silikonowy tampon z kliszy bezpośrednio na produkt. Następnie nadrukowane części są uzbrajane w elementy (blaszki, półprzewodniki, folie dotykowe, itp.). Przygotowane panele trafiają na stanowisko montażu ręcznego, gdzie łączone są z płytką elektroniczną. Panele mogą być wyposażane w komponenty dodatkowe (przyciski, diody, wyświetlacze). Za pomocą prostych narzędzi łączy się pozostałe komponenty i testuje oraz sprawdza funkcjonalność. Następnie produkt jest pakowany i wysyłany do klienta na palecie.

Linia montażu wyświetlaczy TFT to indywidualne stanowiska montażu ręcznego.

Montaż dotykowego wyświetlacza polega na połączeniu dwóch etapów procesu. Pierwszy polega na przyklejeniu do frontowej powierzchni folii reagującej na dotyk (ITO) oraz drugiego polegającego na montażu panelu przedniego, wyświetlacza oraz elektroniki w jedną obudowę.

Proces klejenia folii dotykowej podlega szczególnym wymaganiom czystości powietrza oraz zachowania szczególnych zasad ochrony osobistej w celu redukcji ilości zanieczyszczeń mogących być na wyświetlaczu.

Kolejny etap stanowi standardowy proces montażu płytek elektronicznych z zachowaniem dodatkowych zasad czystości na stanowiskach pracy.

Ostatnim etapem przed spakowaniem i wysyłką jest proces testowania wyrobu. Urządzenia testowe robią dwa rodzaje testów: test komponentów oraz test funkcjonalny.

W laboratorium przeprowadzane są testy środowiskowe, funkcjonalne, mechaniczne i wytrzymałościowe urządzeń elektronicznych oraz komponentów używanych do ich produkcji za pomocą urządzeń testowych.

Prowadzone na narzędziowni prace polegają na obróbce skrawaniem (toczenie, szlifowanie, frezowanie) płyt, elementów i detali ze stali, metali kolorowych (aluminium, brąz, mosiądz) i różnego rodzaju tworzyw sztucznych potrzebnych do tworzenia oprzyrządowania pod zapotrzebowanie produkcyjne – wykonanie przyrządów pod nowe projekty, regeneracja zużytego oprzyrządowania. Prace warsztatu i działu utrzymania ruchu zakładu polegają na utrzymaniu w sprawności eksploatowanego parku maszynowego, instalacji oraz obiektów Zakładu.

Po zrealizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia Zakład będzie kontynuował ten sam rodzaj technologii, jednakże ilość produkcji zostanie zwiększona o 100%.

W czasie realizacji inwestycji wystąpi:

- przemijające zanieczyszczenie powietrza (emisja substancji do powietrza ze spalania paliw - transport),
- wytworzenie odpadów,
- zwiększenie poboru wody oraz większa emisja ścieków,
- okresowe podwyższenie istniejącego klimatu akustycznego.

Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na stan czystości powietrza będą: pojazdy transportujące materiały, maszyny budowlane, procesy spawania.

Emisja występować będzie okresowo, tj. w czasie godzin prowadzenia prac montażowych.

Na etapie montażu oddziaływanie inwestycji, na jakość powietrza będzie niewielkie i ograniczone do najbliższego obszaru.

W związku z montażem instalacji przewiduje się prace budowlane na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów.

Na etapie realizacji inwestycji, działalność wykonawcy może być związana z wytworzeniem odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) klasyfikują się do grupy 15 i 17. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje w zakresie gospodarowania odpadami oraz zapewniających ich właściwe zagospodarowanie lub wpis do rejestru, jeśli będzie obowiązuje rejestr w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Podmioty wraz z przejęciem odpadów przejmą również odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z nimi określonymi w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).

Zakład posiada badania środowiska gruntowo - wodnego, które wskazują na brak jego zanieczyszczenia, w związku z czym nie przewiduje się wytworzenia odpadów niebezpiecznych w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni zawierających substancje niebezpieczne (np. PCB) (17 05 03*) oraz urobku z pogłębienia zawierającego lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (17 05 05*).

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 1271, 852/12 i 852/13 k.m. 4 położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 6.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 52 ppkt. b - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Sprawę prowadzi:

Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi tel. 77 419 03 45.

**Z up. Burmistrza
/-/ Roman Kania**